

Living up to Life



Leica Microsystems SpA | Via Ettore Bugatti 12 | 20142 Milano

8 Ottobre 2008

Oggetto

Sistema di misura Leica DCM 3D per l'acquisizione e la misura di immagini con tecnologia Dual Cole (Confocale & Interferometro).

Gentile cliente,

in un mercato sempre più competitivo ed esigente, Leica Microsystems si propone con soluzioni all'avanguardia nei settori della Ricerca e Controllo Qualità.

Siamo lieti di invitarLa alla presentazione dell'innovativo sistema metrologico tridimensionale Leica DCM 3D, in grado di misurare senza contatto con risoluzioni nanometriche il grado di finitura delle superfici di ogni rugosità, grazie all'integrazione della doppia tecnologia confocale ed interferometrica.

La presenzione si terrà presso le seguenti sedi:

- **INRIM** - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica,

Strada delle Cacce, 91- Torino

30-31 Ottobre 2008 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Tel. +39 02 57486.1
Fax +39 02 5740 3392
www.leica-microsystems.com
email: mktg.it@leica-microsystems.com

Capitale Sociale 1.530.000,00
Registro Imprese Milano 300502
R.E.A. Milano 1327807
Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155

- **CIVEN – Venezia**

Via delle Industrie 17/A – Marghera Venezia

3-4 novembre 2008 dalle ore 9,00 alle 17,00.

- **Università degli Studi di Milano Bicocca** – Dip. Scienze dei Materiali,

Via Cozzi, 53 – Milano

10-11 novembre 2008 dalle ore 9,00 alle 17,00.

Per una migliore gestione organizzativa La preghiamo di confermarci la Sua gentile partecipazione con l'indicazione del giorno e di un orario in modo da potere garantire a tutti l'opportunità di valutare il sistema in funzione delle diverse applicazioni. E' possibile portare i propri campioni.

Gli interessati possono inviare la propria partecipazione a :

Sig.ra Stefania Serra –Leica Microsystems- stefania.serra@leica-microsystems.com

Certi che questo invito risulti di suo interesse, cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.

LEICA MICROSYSTEMS SPA